

---

# 온디바이스AI, AIoT 기반 기업의 국외 시장 진출을 위한 CES 2026 참관 보고서

[출장지역 : 미국(라스베가스)]

---

2026. 1.

## CES 2026 개요

- 행사명 : 국제전자제품박람회(CES: Consumer Electronics Show)  
\* 1967년 뉴욕을 시작으로 58회째 개최되는 전자제품전시회
- 기 간 : 2026년 1월 6일 - 9일 (4일간)
- 장 소 : Las Vegas 내 3개 권역, Convention Center(LVCC) 등
- 주 최 : Consumer Technology Association(CTA)
- 면 적 : 23만m<sup>2</sup>
- 주 제 : Connect, Solve, Discover : Dive In
- 규 모 : 세계 160개국 4,300개사
- 내 용 : AI, 디지털 헬스, 모빌리티, IoT, 스마트 홈, AR./VR, 로봇틱스 등의 기술전시 및 신제품·신기술 소개

### < CES 2026 주제 >

주제	주요 내용
피지컬 AI	로봇틱스와 AI 결합, 제조·물류·서비스 로봇 실용화
공간 컴퓨팅	초경량·몰입형 XR 디스플레이, 공간 인식 인터페이스
디지털 헬스	웨어러블 기반 건강 관리, 안전 모니터링 솔루션
모빌리티	자율주행, 전기차 솔루션, AI 기반 센싱 및 시스템
스마트홈	AI-연계 홈 자동화, 개인 맞춤형 서비스
AI 전환	서비스·제품·산업의 AI 통합 전략
로봇틱스	산업용·생활용 로봇 솔루션 전시
스마트 커뮤니티	IoT·AI 기반 커뮤니티 기술, 도시 인프라 및 연결성 혁신
지속가능성	에너지, 환경 개선 기술 트렌드
차량 기술&고급 모빌리티	자율주행·커넥티드 차량·항공 모빌리티
스페이스 테크	우주 탐사/데이터·통신 기술 등 위성·우주 관련 혁신 기술

## < CES 2026 전시장 구성 >



<b>LVCC Campus</b> (대기업)	<p>West Hall은 모빌리티, North Hall은 AI, 로봇틱스, 디지털헬스 등, Central Hall은 전자·가전 등의 전시와 게임, 메타버스 관련 기업의 혁신 기술이 다수 공개될 예정</p> <p>*Las Vegas Convention and World Trade Center 등</p>
<b>Venetian Campus</b> (스타트업)	<p>스마트홈, 푸드테크 등 분야의 전시 부스와 세계 각국의 스타트업이 모여 있는 유레카파크가 위치</p> <p>Venetian Expo에서는 CES 2025 최고혁신상 수상작의 전시가 진행</p> <p>*Venetian Expo, The Venetian, The Palazzo 등</p>
<b>C Space Campus</b> (키노트, 컨퍼런스)	<p>다양한 컨퍼런스, 네트워킹 이벤트가 준비될 예정이며, 광고, 미디어, 엔터테인먼트, 브랜드 마케팅 등 분야의 전문가들의 모임이 이루어지는 C Space에서 다양한 행사가 진행될 예정</p> <p>*Aria, Cosmopolitan, Park MGM 등</p>

# 1 CES 2026 주요 현황

- CES 2025는 “Innovators show up, 혁신가들의 등장”이라는 슬로건으로 온디바이스 AI, 피지컬 AI, 로봇틱스, 모빌리티 등 AI가 모든 산업과 일상에 스며드는 모습이 집중 조명, 전년에 비해 참가기관(4,800→4300)은 줄었으나, 참가자(14.2만→14.8만)는 증가

## □ 참가 기업 및 국가 현황

○ (연도별 참가기관 수) ('24) 4,300 → ('25) 4,800 → ('26) 4,300

구분	미국	중국	한국	프랑스	대만	캐나다	일본	독일
2023	1,484	502	469	233	175	82	60	59
2024	1,147	1,104	705	195	178	72	73	62
2025	1,509	1,339	1,031	189	173	83	100	68
2026	1,476	942	853	160	132	77	104	57

\* 출처 : CTA 홈페이지 Results for Exhibitor Directory(2025년) + 지디넷코리아 보도자료(1.3) 반영

○ (국내기업 현황) 미국, 중국에 이어 3번째로 많은 국내기업이 CES2026에 참가하였으며, 220건의 혁신상, 19건의 최고혁신상 수상

- CES 2026 혁신상 446건 중 220건 수상(49%), 최고혁신상 43건 중 19건(44%)으로 참가국 중 가장 높은 비율

## □ 핵심 기술 트렌드 변화

10개년 CES 핵심 기술 트렌드 변화 (2017~2026)										2026년 핵심 테마
인공지능 등장 자율주행 강조			코로나19 확산, 온라인/비대면 기술 강조			온·오프라인 하이브리드 기술의 발전			AI 기반 생태계 부각	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						인간안보			인간안보	
		5G							5G	
	스마트시티								스마트시티	
	로봇								로봇틱스	
인공지능							생성형AI		엔비언트 AI	
드론									드론	
웨어러블 기기					디지털 헬스				디지털 헬스	
AR/VR		AR/VR/MR	XR		메타버스			AR/VR/XR	AR/VR/XR	
자율주행			차세대 교통			모빌리티			모빌리티	
4K TV		8K TV			디스플레이				디스플레이	
스마트홈									스마트홈	
		Resilient Tech		ESG	Sustainability				Sustainability	
			푸드테크						푸드테크	
					NFT	웹3.0			양자	
					우주기술				우주기술	

\* 자료 : 더밀크, 삼일PwC경영연구원

## AI & Infrastructure




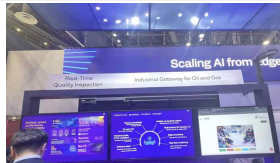
(AI반도체지원본부 온디바이스AI팀)

### □ 개요

- CES 2026은 AI가 개념·실험 단계를 넘어 실제 산업과 일상에서 작동하는 단계로 진입했음을 명확히 보여줌
  - CES 2025가 생성형 AI를 중심으로 한 ‘AI Everywhere’의 출발점이었다면, CES 2026은 ‘AI at Work, AI in Reality’로의 전환점으로 평가
  - AI는 더 이상 화면 속 소프트웨어나 데모용 기술이 아니라, 로봇·모빌리티·제조·헬스케어 등 물리적 세계를 직접 인식·판단·제어하는 ‘Physical AI’로 진화





### □ 주요 내용

- AI반도체 : 단일 칩 경쟁에서 AI시스템·플랫폼 경쟁으로 전환
  - GPU·NPU 단품 성능을 강조하는 수준을 넘어, AI를 안정적으로 대규모 운영하기 위한 시스템 단위 경쟁으로 진화

제품		주요 내용
NVIDIA		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vera Rubin 아키텍처를 중심으로, 개별 GPU가 아닌 데이터센터 전체를 AI Factory로 설계운영</li> <li>▪ 수십개의 GPU를 하나의 랙 단위로 통합</li> <li>▪ 메모리·네트워크·스토리지의 일체형 설계</li> </ul>
AMD		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MI 시리즈 GPU와 CPU를 결합한 랙 스케일 AI 서버를 통해, 대규모 학습뿐 아니라 AI 추론서비스 운영 최적화를 강조</li> <li>▪ 랙 스케일 AI 시스템(Helios 등) 제시</li> <li>▪ HBM 기반 고대역폭 메모리 전략</li> </ul>
Intel		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AI PC와 엣지 환경을 중심으로 한 온디바이스 AI 확산 전략을 전면제시</li> <li>▪ 로컬 LLM, 비전·음성 AI 온디바이스 실행</li> </ul>
Qualcomm		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Snapdragon SoC 기반 저전력·고효율 NPU 중심 온디바이스 AI 전략을 가장 명확히 제시</li> <li>▪ 스마트폰, AI PC, XR, 자동차까지 확장</li> <li>▪ 네트워크 연결 없는 로컬 AI 실행</li> </ul>



- 온디바이스AI : 단일 기능 탑재에서 디바이스·현장 운영형 AI로 전환
  - 클라우드 연계형 보조 기능 수준을 넘어, AI를 디바이스 내부에서 상시·실시간 운영하기 위한 구조로 진화
  - AI 추론을 클라우드에 의존하지 않고 로컬에서 수행함으로써 지연(latency)·연결성·보안·비용 문제를 동시에 해결
  - 스마트폰·AI PC를 넘어 로봇·모빌리티·산업 설비 등 물리 환경 제어 영역으로 적용 범위 확장
  - 단말 단위 AI 탑재 경쟁에서 벗어나, NPU·소프트웨어·시스템 통합을 통한 운영 가능한 온디바이스 AI 플랫폼 경쟁으로 이동

제품		주요 내용
<b>DeepX</b> 혁신상 우리원지원		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 초저전력 Physical AI NPU를 중심으로 로봇드론·제조 현장용 온디바이스 AI 인프라 비전을 제시</li> <li>▪ Sixfab 등 파트너와의 협력을 통해 CES 혁신상 수상</li> </ul>
<b>Mobilint</b> 혁신상 우리원지원		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 산업용 엣지 AI 프로세서 기반 실시간 AI 추론 시연을 통해, GPU 대비 저전력·저비용·현장 최적화 NPU의 경쟁력을 부각</li> </ul>
<b>Sixfab</b> 최고혁신상		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sixfab은 DeepX NPU를 탑재한 ALPON X5 영상센서분석용 온디바이스AI 컴퓨터로 고성능 AI연산을 소형 하드웨어로 구현, Best of Innovation을 수상</li> </ul>
<b>Intellivix</b> 혁신상 우리원지원		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 비전 AI 특화 온디바이스 AI 기반 지능형 영상 분석</li> <li>▪ 영상 보안·관제 분야에서 AI 추론을 카메라/현장 단에서 수행하는 온디바이스 비전 AI 적용</li> </ul>

## □ 시사점

- CES 2026은 AI 반도체 경쟁이 칩 성능 중심 단계에서 AI 시스템·플랫폼 경쟁 단계로 진입했음을 보여줌
  - AI반도체는 더 이상 고성능 칩 확보 문제가 아니라, AI연산을 얼마나 지속적으로 운영·확장하는 플랫폼 역량 확보 문제
- CES 2026의 AI 반도체·온디바이스 AI 전시는 AI 연산의 중심이 클라우드 단독 구조에서 → 클라우드 + 엣지 + 디바이스 분산 구조로 이동
  - 온디바이스 AI는 ① 연산(DeepX) → ② 산업 적용(Mobilint) → ③ 시스템 확산(Sixfab)으로 이어지는 가치 사슬 구조를 형성

## □ 정책연계

- 클라우드 중심 AI 구조의 한계를 보완하기 위해, 현장 자립형 온디바이스 AI 활용을 국가 AI 전략에 명확히 반영할 필요
  - 지연·보안·통신 비용 문제를 해결할 수 있는 온디바이스AI를 공공·산업·스마트시티 분야의 우선 적용 기술로 설정하고, 클라우드 의존도를 단계적으로 완화할 필요가 있음
- 온디바이스AI팀에서 추진하고 있는 실증 과제 지원과 현장 적용 레퍼런스 확보를 통해 공공·산업 영역에서 국산 온디바이스 AI의 우선 적용 기반을 마련할 필요가 있음
- 온디바이스 AI를 단일 반도체 기술이 아닌 반도체-시스템-서비스가 결합된 운영형 AI 인프라로 인식하고, 전주기 지원 정책 마련이 필요
  - NPU 설계부터 엣지 AI 시스템, 현장 운영 소프트웨어까지 연계하는 패키지형 정책 지원을 통해 기술 상용화 및 확산을 촉진할 필요가 있음
- 연산 성능 지표 중심 평가에서 벗어나, 현장 배포 규모, 실시간 운영 안정성, 클라우드 비용 절감 효과 등 실제 활용 성과 중심의 정책 평가 체계로 전환할 필요가 있음